

Compression Molding System

Model CPM1180



**Compression molding system
for large size PLP molding to meet industry needs**

業界ニーズに応える超大判PLP成形を実現する コンプレッションモールド装置

製品情報



日本語

- 超大判パネル最大660mm×620mmの自動成形が可能
- 超大判サイズに最適な成形技術を採用
- 独自のキャビティダウン方式を採用し、高品質な成形を実現
- 顆粒樹脂の均一な散布により安定した成形が可能
- プレスモジュールの増減による生産数量の変化への対応



SPECIFICATION

Items		Unit	Description			
モデル		—	CPM1180			
装置区分		—	Manual	Semi-Auto	Full-Auto	
ワークタイプ		—	パネル・ウェハ			
ワークサイズ	パネル	mm	625 × 620 (Max. 660 × 620)			
	ウェハ	mm	φ 450 (Max.)	—	—	
樹脂		—	顆粒			
マシンタイム		sec	—	—	Approximately 75	
外形寸法	プレス数	module	1	1	1	2
	幅	mm	2,000	4,395	7,050	8,990
	奥行き	mm	2,670	2,670	3,750	3,750
	高さ	mm	2,285	2,285	2,285	2,285
重量		ton	12.3	18.6	23.0	35.0
成形取り数		workpiece	1	1	1	2
マガジンスペース		—	—	—	FOUP Input/Output stage : 1 cassette each In/Out stage : Panel 1 by 1	
クランプ出力		kN/(tf)	49.0—1,764.0/5.0—180.0			
クランプ速度		mm/sec	70 (Max.)			
品種切替え方式		—	—	キット交換式		
リリースフィルム幅		mm	740 (Max.)			

・上記数値は当社標準機の場合です。
・改良のため仕様を変更する事があります。
・特殊システム仕様についてはご相談ください。



本社

〒601-8105
京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地

お問い合わせ先



TOWA (当社のハウスマーク)、 はTOWA株式会社の商標または登録商標です。

海外販売拠点

中国
TOWA (Shanghai) Co., Ltd.

台湾
TOWA Taiwan Co., Ltd.

韓国
TOWA Korea Co., Ltd.

シンガポール
TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

マレーシア
TOWA MALAYSIA SALES
& SERVICES SDN. BHD.

タイ
TOWA THAI COMPANY LIMITED

フィリピン
TOWA Semiconductor Equipment
Philippines Corp.

インド
TOWA SEMICONDUCTOR INDIA
PRIVATE LIMITED

ドイツ
TOWA Europe GmbH

オランダ
TOWA Europe B.V.

アメリカ
TOWA USA Corporation

20250501-006-HQ